【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公開番号】特開2018-201184(P2018-201184A)
【公開日】平成30年12月20日(2018.12.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-049
【出願番号】特願2017-106270(P2017-106270)
【国際特許分類】
Ｈ０３Ｈ　9/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０３Ｈ　9/24　B

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月9日(2020.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
素子を有する素子基板と、
前記素子基板を支持する支持基板と、
前記素子基板に配置される素子電極と、
前記素子基板に配置され、前記素子電極に接続する電極パッドと、
前記素子基板と前記電極パッドとの間に配置される素子調整層と、
前記素子調整層の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置される第１の貫通孔と、
前記素子基板の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置され、第１の貫通孔と連通する第２の貫通孔と、
前記支持基板の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置され、第２の貫通孔と連通する第３の貫通孔と、
前記第１の貫通孔、前記第２の貫通孔および前記第３の貫通孔に配置され、前記電極パッドと導通する配線電極と、を有し、
前記第１の貫通孔の開口幅は、前記第２の貫通孔の開口幅よりも小さい、ＭＥＭＳ素子。
【請求項２】
前記第１の貫通孔を複数有し、
複数の前記第１の貫通孔を離間させる隔壁を有する請求項１に記載のＭＥＭＳ素子。
【請求項３】
３つ以上の前記隔壁が１点で交差する請求項２に記載のＭＥＭＳ素子。
【請求項４】
素子を有する素子基板と、
前記素子基板を支持する支持基板と、
前記素子基板に配置される素子電極と、
前記素子基板に配置され前記素子電極に接続する電極パッドと、
前記素子基板と前記電極パッドとの間に配置される素子調整層と、
前記素子調整層の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置される第１の貫通孔と、

前記素子基板の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置され、第１の貫通孔と連通する第２の貫通孔と、
前記支持基板の、平面視で前記電極パッドと重なる位置に配置され、第２の貫通孔と連通する第３の貫通孔と、
前記第１の貫通孔、前記第２の貫通孔および前記第３の貫通孔に配置され、前記電極パッドと導通する配線電極と、を有し、
前記第１の貫通孔の開口幅および前記第２の貫通孔の開口幅は、前記第３の貫通孔の開口幅よりも小さい、ＭＥＭＳ素子。
【請求項５】
前記第１の貫通孔と前記第２の貫通孔とは、平面視で重なる部分を有する、請求項４に記載のＭＥＭＳ素子。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載のＭＥＭＳ素子を備える電子機器。
【請求項７】
請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載のＭＥＭＳ素子を備える移動体。